



NXP, JCOP 페이로 결제 카드 맞춤화 지원

- JCOP 5 EMV 기반 NXP 신규 JCOP 페이로 보안과 높은 맞춤화 기능 제공... 변화하는
요구사항 충족



JCOP 5 EMV에서 작동하는 NXP의 새로운 JCOP 페이는 결제 카드에 대한 높은 수준의 고객 맞춤화를 제공하는 동시에 보안을 강화하도록 설계되었다.

2024년 8월 7일, 대한민국 서울 – NXP 반도체가 JCOP5 EMV®(Java Card Open Platform 5 Europay-Master-Visa)에서 작동하는 JCOP 페이(JCOP Pay)를 발표했다. JCOP 페이는 보안을 강화하며 결제 카드에 대한 높은 수준의 고객 맞춤화를 제공하도록 설계됐다. 최근 획득한 EMVCo 인증을 통해 고객이 카드 발급 기간을 연장할 수 있도록 지원한다.

결제 카드 제조업체는 경쟁이 치열한 업계에서 끊임없이 변화하는 소비자의 니즈에 대응해야 하므로 재고 관리가 까다롭다. JCOP 5 EMV에서 운영되는 JCOP 페이는 카드가 최종 소비자에게 발급되는 시점까지 유연하고 안전한 재구성이 가능해 결제 방식 애플리케이션과 설정을 변경할 수 있다. 이를 통해 고객은 효율적인 재고 관리가 가능하며, 특수한 다중 애플리케이션 요청을 고려해 향상된 맞춤화 옵션을 제공받고 전반적인 유연성을 높일 수 있다.



NXP 보안 결제 및 신원 확인 부문 수석 이사인 크리스티안 라크너(Christian Lackner)는 "결제 카드 발급사에게 맞춤화와 유연성은 매우 중요하다. 최신 JCOP 페이는 유연하고 안전한 재구성 옵션을 제공해 고객이 기존 재고를 변화하는 소비자 요구에 신속히 대응할 수 있게 한다. 이는 궁극적으로 경쟁이 치열한 업계에서 성공하는 데 필요한 유연성 확보를 돕는다"라고 말했다.

JCOP 페이는 국내 결제 체계 생성을 지원하는 화이트 라벨 연합(White Label Alliance, WLA)의 WLA 표준을 비롯, 모든 주요 결제 체계를 위한 상용 솔루션을 제공한다. 더불어 JCOP 5 EMV에서 작동하는 JCOP 페이는 보안 핀 공유 기능을 갖췄다. 소비자는 보안을 유지하면서 동일한 카드와 핀으로 여러 결제 방식을 안전하게 사용할 수 있다.

JCOP 5 EMV에서 작동하는 JCOP 페이는 2030년까지 EMVCo ICCN 인증을 받았으며, JCOP 4 EMV에서 작동하는 기존 JCOP 페이와 역호환성을 지원한다. 더불어 차세대 EMV 애플리케이션을 위한 타원 곡선 암호화(elliptic curve cryptography, ECC) 알고리즘을 제공한다.

또한 JCOP 페이는 기존의 와이어 본드(wire bond)와 유도 결합(inductive coupling)에 최적화돼 안테나 튜닝(antenna tuning)이 용이하고 카드 제조 시 허용 오차 범위 내에서 보다 높은 수율을 구현할 수 있다.

JCOP Pay는 2024년 4분기에 출시될 예정이다. 자세한 내용은 [여기](#)에서 확인할 수 있다.

###

NXP 반도체 소개

NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 뛰어난 인재들을 모아 더욱 살기 좋고 안전하며 보안 수준이 높은 연결된 세상을 만드는 혁신적인 기술을 개발하고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고, 보다 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있는 솔루션을 제공한다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 34,200명의 직원을 고용하고 있다. 2023년 매출은 미화 132억 8천만 달러다. 더 자세한 내용은 <http://www.nxp.com/> 에서 찾아볼 수 있다.